

SVERIGE

(12) **PATENTSKRIFT**(13) **C2** (11) **522 867**

(19) SE

(51) Internationell klass 7
H01L 7/02, 1/18
**PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET**
(45) Patent meddelat **2004-03-16**(41) Ansökan allmänt tillgänglig **2001-12-21**(22) Patentansökan inkom **2001-06-19**(24) Löpdag **2001-06-19**

(62) Stamansökans nummer

(86) Internationell ingivningsdag

(86) Ingivningsdag för ansökan
om europeisk patent

(83) Deposition av mikroorganism

(21) Patentansöknings-
nummer **0102167-4**

Ansökan inkommen som:

☒ svensk patentansökan
fullföljd internationell patentansökan
med nummer

☐ omvandlad europeisk patentansökan
med nummer

(30) Prioritetsuppgifter

2000-06-20 JP 12/184046(73) PATENTHAVARE **Murata Mfg Co Ltd, 26-10 Tenjin 2-chome Kyoto-fu 226
Nagaokakyo-shi JP**(72) UPPFINNARE **Toshifumi Oida, Nagaokakyo-shi JP, Norio Nakkajima,
Nagaokakyo-shi JP, Eigoro Ina, Nagaokakyo-shi JP, Takahiro
Watanabe, Nagaokakyo-shi JP**(74) OMBUD **Zacco Sweden AB (publ)**(54) BENÄMNING **RF-modul**

(56) ANFÖRDA PUBLIKATIONER:

EP A2 0 996 155 (H01L 23/36), US A 5 450 046 (H03H 11/02)

(57) SAMMANDRAG:

RF-modulen är försedd med ett flerskiktssubstrat. En IC-bas-bandkrets, en IC-minneskrets, en kvartsoscillator och ytmonterade komponenter är monterade på flerskiktssubstratets översida. En metallkåpa är även fästad på flerskiktssubstratets översida. Ett hålrum är utformat i flerskiktssubstratets undersida, väsentligen i mitten av detsamma. En första RF-IC-krets och en andra RF-IC-krets är inbäddade i hålrummet. Ledningsmönster 32 för förbindelse mellan IC-basbandkretsen och IC-minneskretsen, genomgående hål, passiva RF-komponenter, och avskärmande jordelektrodmönster är utformade inne i flerskiktssubstratet.

